



平成 29 年 8 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O
代表者名 代表取締役 会長兼 CEO 橋本 眞幸
(コード: 3 4 3 6 東証第一部)
問合せ先 広報・IR 室長 澁谷 博史
(TEL. 03 - 5444 - 3915)

設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、設備投資を実施することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設備投資の理由

300mm シリコンウェーハは、今後ますます市場が伸長する見通しであります。その中でも最先端半導体用高精度ウェーハは今後、最も需要が増加する見込みですが、サプライヤーの数も限られていることから、特に需給がひっ迫すると予測されます。このような状況下、当社は市場シェアの高い 300mm 最先端半導体用高精度ウェーハの供給責任を果たすために、顧客との長期販売契約に基づき、平成 31 年上期を目標に月産 11 万枚の増強投資を自己資金にて実施することを決定いたしました。

2. 設備投資の内容

- | | |
|------------|--------------------|
| a) 対象資産の名称 | 300mm シリコンウェーハ製造設備 |
| b) 所在地 | 佐賀県伊万里市 |
| c) 投資予定額 | 436 億円 |
| d) 資金調達方法 | 自己資金 |

3. 稼動予定時期

平成 31 年上期

4. 今後の見通し

本設備投資による当期業績への影響はありません。

以 上